



シルセスキオキサン脂環式酸二無水物 DDSQ

－高耐熱樹脂向けモノマー－

製品

ダブルデッカー型シルセスキオキサンを脂環式酸二無水物にした二官能性モノマー

用途

高耐熱樹脂原料（ポリイミド、エポキシ等）

特徴

高耐熱樹脂の主鎖に組み込むことで低誘電・低線熱膨張などの特性付与が可能

背景

BACKGROUND

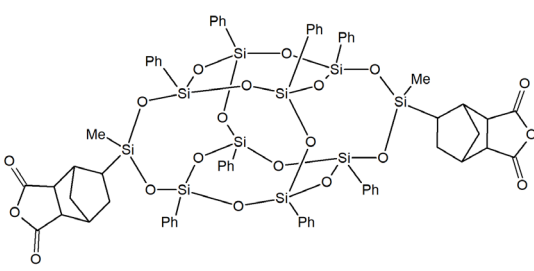
JNC（株）が開発したダブルデッカー型シルセスキオキサンの脂環式酸二無水物について、日本材料技研（株）にてライセンス契約を締結して事業化を進めています

製品概要

PRODUCT OVERVIEW

低誘電かつ高耐熱なケイ素化合物であるシルセスキオキサンの中でも、特に嵩高く剛直な構造を持ち耐熱性・機械強度に優れたダブルデッカー型シルセスキオキサンを二官能化した脂環式酸二無水物です。

ポリイミドやエポキシ等の高耐熱樹脂の主鎖にダブルデッカー型シルセスキオキサンを組み込むことで、耐熱性の向上に加えて、低誘電・低線熱膨張などの特性を付与することが期待できます。

CAS No.	948849-07-8	<p><構造式></p> 
分子式	$C_{68}H_{64}O_{20}Si_{10}$	
モル質量	1482.09	
融点	277～335°C	
熱分解温度	435°C	
酸無水物当量	909g/eq.	
かさ密度	0.22g/ml	
性状	白色粉末	

製品の特徴

PRODUCT FEATURE

低誘電

誘電率2.4～2.8
(ポリイミドの合成例)

高耐熱

耐熱温度500°C前後
(ポリイミドの合成例)

低Tg

Tg250～270°C
(ポリイミドの合成例)

お問い合わせ先